

证券代码：603163

公司简称：圣晖集成

编号：2025-004

圣晖系统集成集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

提示说明：公司每月定期汇总披露投资者关系活动记录表，于每月最后一个交易日盘后披露

活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☒其他（“我是股东、走进上市公司”专题活动）
参与单位名称及人员姓名	1、通过上证路演中心参与“圣晖集成 2025 年第三季度业绩说明会”的投资者 2、机构投资者、分析师、研究员 东吴证券、广发证券、长江证券、华泰证券、天风证券、国投证券、国金证券、国信证券、方正证券、中邮证券、平安基金、申万菱信基金、华安基金、华夏基金、浦银安盛基金、UBS、人保资产、鲁信创投、盘京投资、财通资管、中财集团、保德信资管、工银瑞信、Willing Capital、中信建投、博时基金、博云创投 3、“我是股东、走进上市公司”专题活动参与人员 侯鹏、周兵、江彪、许志强、顾晓静、徐泽洲、程功、马丽、叶敬格、石建彬、王宗芹、霍金、石常瑞、罗海艳、许琴、欧中阳，杨娜，陈鑫淼，王娜，王春松
活动时间	2025 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 24 日、10 月 29 日
地点	圣晖集成办公室、上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	副董事长兼董事会秘书陈志豪先生、总经理朱启华先生、工程副总张金保先生、财务总监萧静霞女士、独立董事董炳和先生、刘铁华女士、刘琼先生、IR 经理黄雅萍女士、证券事务代表高杰杰女士
问答交流主要内容介绍	问题 1. 公司三季度半导体行业在手订单回升至 16.33 亿元，且海外新签单占比显著提升，请问目前东南亚半导体建厂潮下，公司针对台积电、联电等核心客户的项目交付进度是否符合预期？ 答：公司目前没有台积电、联电的在建项目。其他核心客户的海外各项目，均在有序推进中。 问题 2. 请问管理层，这些充裕的订单预计将在何时集中转化为收入？海外业务的高速增长势头未来能否持续？ 答：除二次配工程需配合业主机台进场时间进行施工外，其他项目通常而言，国内项目的密集执行期约为 6 至 9 个月，海外项目的密集

	执行期约为 9 至 12 个月。基于公司所处行业下游的发展趋势，公司对海外业务的增长持审慎、乐观态度。
	问题 3. 请问公司如何评估当前的回款风险？ 答：公司当前回款风险整体可控。虽然应收账款因业务快速扩张及大型项目结算周期有所增加，但公司客户主要集中在资信良好的半导体和精密制造行业，且已建立完善的应收账款动态监控体系。目前公司在手订单充足，现金流稳健，能够保障业务发展需求。
	问题 4. 公司三季度毛利率下滑的原因？ 答：公司为深化战略客户合作、巩固市场地位，承接了个别金额较大但毛利率较低的项目，本报告期内已陆续确认收入，短期内对毛利率构成一定压力；海外主要源于个别大项目的合同外变更成本尚未完成议价确认，其相关利润暂不纳入当期财务报表。公司正通过价格追加协商、价值工程优化等积极举措，预计随着结算推进，相关变更条款将逐步达成一致，境外毛利率存在第四季度得到改善的可能性。
	问题 5. 公司对第四季度新签订单的展望如何？ 答：具体订单仍待后续招标流程推进和最终落地，但可以观察到，随着融资环境的逐步改善，相关行业的资本开支景气度正呈现回升态势。基于当前项目储备及客户扩产规划，公司对下半年业绩延续快速增长势头持谨慎乐观态度。尤其在半导体建厂和高端面板产线建设领域，公司凭借深厚的技术积累和稳定的客户资源，已建立起较强的竞争优势，有望持续受益于本轮产能扩张周期。
	问题 6. 现有在手订单在第四季度能有多少转化为收入？境内和境外转化速度是否有区别？ 答：截至 2025 年 9 月 30 日，公司在手订单余额为 22.14 亿元（未含税），比上年同期增长 21.21%。其中，IC 半导体行业在手订单余额为 16.33 亿元（未含税），精密制造行业在手订单余额为 4.64 亿元（未含税），光电及其他行业在手订单余额为 1.17 亿元（未含税）。 公司严格按照与客户合同约定的工期安排实施项目，按照履约进度逐步确认收入。不考虑二次配项目的情况下（二次配业务收入转化情况可能会受到业主方机台分批到货的影响），国内订单一般在 6-9 个月内可以确认大部分收入，海外订单转化为收入的时间较国内略有延迟，大部分订单可以在 9-12 个月内陆续确认大部分收入。个别大型或复杂度较高的项目，受体量及执行条款影响，完整收入确认可能延续至 1-2 年，实际转化节奏将严格依据项目进度、行业特性及合同具体约定分期实现。
	问题 7. 美国市场的拓展进展如何？业务上有什么规划？ 答：目前已确认由台湾圣晖先行投资设立美国子公司，预计 2025 年 12 月底完成设立流程。业务上初步规划依据双方投入资源占比划分，具体方案仍在进一步商议中。人员签证办理工作已启动，若进展顺利，预计三至四个月左右有望完成相关人员的落地安排。供应链体系搭建及合作方拓展工作正持续推进，我们期待明年在美国市场实现业务突破，并逐步提升该市场业务占比。从市场特性来看，

	美国客户发包多倾向“大总包”模式，后续再拆解为土建、气体、化学等细分环节；关于美国市场订单质量，目前仍需结合业务推进进一步跟踪验证，暂无法给出明确判断。
	问题 8. 公司人员增长情况及外派美国的人员计划？ 答：截止 2024 年末，公司员工总数为 714 人，预计今年人力增幅较往年将有所提高。关于美国业务的人员派遣，目前计划以“高阶工程主管+资深工程师+一般工程师”的结构。具体外派规模将根据实际签证获批情况动态调整，现阶段尚未设定具体人数目标。
	问题 9. 公司在不同区域的资源投入策略？ 答：公司资源投入遵循利润导向原则。目前，国内和东南亚市场作为成熟区域继续巩固；美国市场作为战略重点优先开拓，现阶段处于规划状态，尚未实际开展商务与项目工作。
	问题 10. 公司在数据中心领域的参与情况？ 答：公司目前在国内尚未承接数据中心项目，在海外市场正积极跟进，去年有参与马来西亚谷歌数据中心的投标，未来将继续关注海外数据中心项目机会。
	问题 11. 公司当前人均产值较同业比偏低的原因及提升路径 答：公司人均产值相较同业偏低，主要受部分大型项目处于收尾阶段、结算周期较长的影响。此阶段项目已基本无实质效益，但仍需配置专人负责验收、结算等流程。这些人员被长期占用在非增值环节，无法转移至新开工项目创造增量价值。目前公司已意识到问题核心，正围绕人员配置优化推进解决方案，计划在年底重新规划人力布局，重点解决收尾阶段的人力冗余问题，以提升整体资源周转效率。
	问题 12. 公司对未来 2-3 年的增长指引及对行业竞争态势的判断？ 答：在全球人工智能技术加速迭代的背景下，国际半导体巨头及云端服务供应商持续加码资本支出布局，战略性推进先进制程研发。这一轮技术革新浪潮正带动半导体全产业链协同发展，从上游的大尺寸硅片及特种半导体材料制备，到核心制程设备与先进封装测试技术突破，乃至下游 SMT 精密组装环节，各细分领域均呈现需求增长态势。在 AI 大模型快速迭代与广泛应用，以及汽车电动化/智能化等浪潮下，服务器、汽车 PCB 将迎来量价齐升机遇。PCB 整体需求保持上升趋势。公司服务的下游行业包括 IC 半导体、电子元器件、光电面板、医药生技、食品饮料等行业，其中以 IC 半导体、光电面板、精密制造等为代表的高科技产业客户是公司的主要服务对象。下游行业的蓬勃发展也为洁净室工程行业带来了成长空间。我们乐观、审慎的看待行业未来的发展趋势。关于行业竞争态势方面，从现有竞标的过程中感受到“内卷”竞争态势有所缓和，竞争环境正趋向理性。
	问题 13. 公司内部同业竞争的协调机制是怎样的？ 答：公司在上市时已与母公司台湾圣晖就同业竞争问题签署《避免同业竞争承诺》，通过明确的地域划分确立了各自的业务范围，台湾圣晖从事洁净室工程相关服务的区域主要在中国台湾地区，中国

	台湾以外的洁净室工程市场属于圣晖集成的业务范围，双方独立地在各自区域开展经营活动。 若由于相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因不适合由圣晖集成去开展业务的区域，为满足客户需求，避免培养未来潜在竞争者，排除未来公司进入该市场之障碍，充分把握“多客户、多产业、多任务种、多区域”的发展策略给圣晖集成带来的战略机遇，维护公司及全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，台湾圣晖对原承诺的部分条款进行变更，由母公司台湾圣晖先行开展该市场运营。 台湾圣晖已做出承诺，待相关业务或资产符合注入圣晖集成或其下属企业的条件后，将在符合相关法律法规及监管规则、符合圣晖集成利益的前提下，圣晖集成有优先购买相关业务或资产的权利，能够享有台湾圣晖代为培育的成果，符合圣晖集成和全体股东的利益。
	问题 14. 上游的设备材料是公司采购还是业主采购？ 答：在项目执行中，设备与材料的采购责任划分依客户与项目类型而定。在绝大部分国内项目中，除客户自备的核心生产设备外，所有厂务系统设备及主要材料均由公司作为工程方采购。仅个别客户会指定部分设备品牌或分包商，但采购流程仍通过公司进行，此类情况占比很低；海外项目通常出于简化管理流程、明确责任界面的考虑多由施工单位采购，业主较少采用指定模式。
	问题 15. 员工持股平台的减持情况？ 答：目前有一个员工持股平台正在根据预披露公告的额度进行减持，后续减持完成后我们会根据交易所的要求披露减持结果公告。
	问题 16. 公司不同产业板块的业务收入占比情况？ 答：根据既往数据显示，公司营业收入按照客户所属行业划分，来自 IC 半导体和精密制造行业的营收占营业总收入的比例在 90%左右。
	问题 17. 海外市场的区域分工是怎样的？ 答：公司海外业务呈现清晰的区域化特征：越南市场以 SMT 产业为主，PCB 产业也有落地；泰国市场则以 PCB 产业为核心；马来西亚则承接了部分半导体封测产能的转移。
	问题 18. 公司与设计院的合作模式及自身设计工作的价值？ 答：国内主流半导体工厂设计主要由十一科技和世源科技承担。设计院主要负责满足国家与行业的强制性规范，出具基础设计图纸。公司在此基础上进行二次深化设计，此部分工作量约占整体设计的 30%，核心在于将图纸转化为更贴合业主实际生产需求的解决方案，这是公司的关键竞争力之一。
	问题 19. 公司如何运用 CFD 气流模拟这类第三方工具？ 答：对于要求较高的高端项目，公司会进行 CFD 气流模拟。我们近期有一个半导体洁净室项目，就与武汉科技大学合作，针对特定生产设备布局与气流组织形式进行了 CFD 仿真分析与优化。此类合作有效提升了设计方案的科学性与可靠性，也为项目在能耗控制与洁净度稳定性方面提供了关键支撑。

	问题 20. 在工程项目的子系统工程中，国产化率最低的环节是什么？ 答：纯水系统是目前国产化率最低的环节，其核心设备和材料仍以进口为主。相比之下，其他系统的国产化程度已显著提高。
	问题 21. 公司与主要竞争对手相比，竞争优势何在？ 答：相较于同业，公司优势在于流程更灵活、响应更迅速，能更好地适应国内客户需求；客户结构更为多元，避免了单一客户依赖；坚守工程品质，由工程人员服务好现有客户以获取后续订单来保障服务的一致性与高品质，老客户重复下订单的比例较高。
	问题 22. 公司的人员结构、招聘与培养策略？ 答：公司人员规模已从五年前的约 400 人增长至近 800 人。技术人员以专科和本科为主，专业背景集中在暖通、电气、给排水等领域。公司坚持自主培养，新员工需经历为期三年的“师徒制”系统化培养方能独立负责项目。在组织架构上，公司采用以客户与区域为导向的事业群模式，设立 IC 半导体事业群、华中事业群、外商投资事业群和大马事业群四大板块，分别专注于集成电路制造、华南区域重点客户、外资企业以及马来西亚周边海外市场的业务开展与客户服务。
	问题 23. 公司的薪资水平如何？ 答：公司薪酬结构为“基本薪资+绩效奖金”。固定薪资处于市场中上水平，但绩效奖金弹性很大，使得员工总收入在业绩良好时可高于市场平均水平。
	问题 24. 2024 年经营性现金流为负的原因？ 答：主要原因是 2024 年执行的工案中，已完工未结算的项目金额较大，存在垫资情况；同时，应收账款回款速度未及预期，两者共同导致了经营性现金流为负。该情形在三季度已得到改善。
	问题 25. 公司对未来增长动力的判断？ 答：公司对未来持乐观态度。短期内，PCB 产业尤其是与 AI 服务器、车载电子相关的 HDI 板是确定性最高的增长动力，在国内外均快速扩张。IC 半导体方面，成熟制程持续扩产，而公司正在等待国内先进制程突破所带来的下一个大的投资周期。
日期	2025 年 10 月汇总